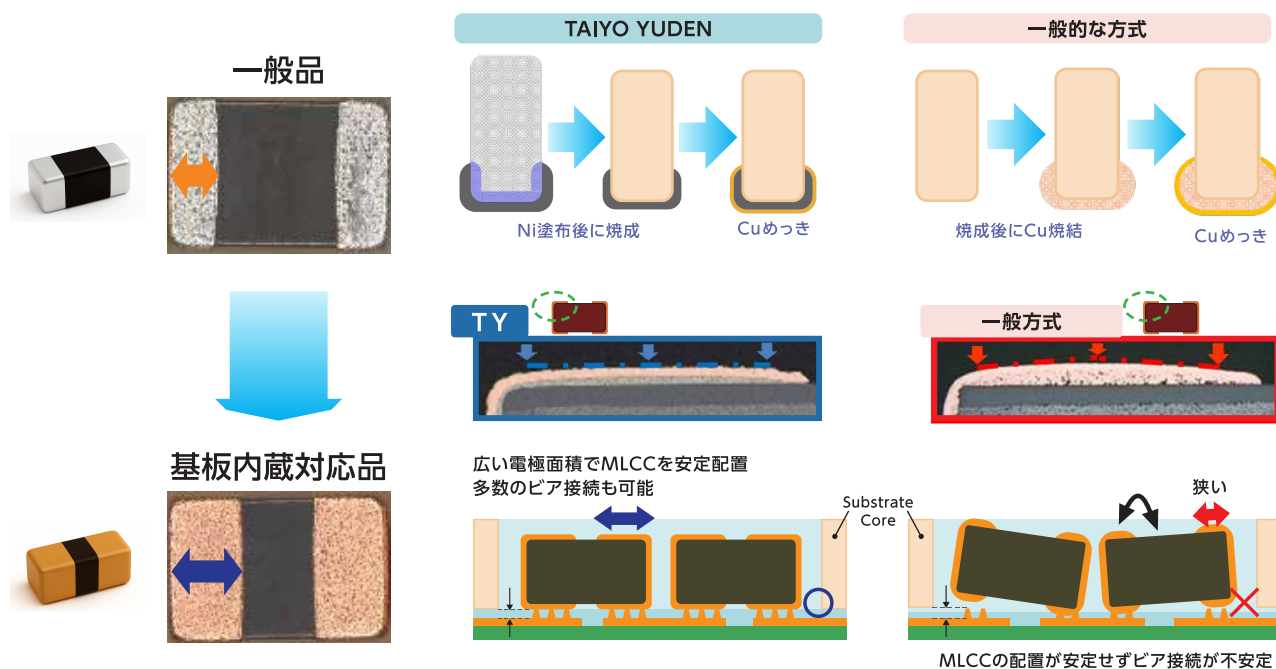


太陽誘電の埋め込みソリューションの強み

積層セラミックコンデンサ (MLCC)

太陽誘電の工法は、外部電極の平坦性に優れ、ビア接続構造による基板への埋め込みに適しています。

また、広い外部電極により高い保持力を実現し、MLCCを所定位置に安定して固定できます。



パワーインダクタ

LSCNシリーズは、高密度磁性材料と高い設計自由度により、優れた性能と幅広い設計対応力を実現します。

Inductor Technology		一般的な方式		LSCNシリーズ ^{※2}	
		ACI ^{※1}	Composite core ^{※1}	Single Coil	Top to Bottom
Magnetic Material	Packing Density	— (Non-Magnetic)	Low	High	High
	Inductance	1.2n H	2.5nH	26nH	4.5nH
Inductor specifications	DC Resistance	7mΩ	12mΩ	19.4mΩ	0.8mΩ
	I _{max} ^{※3}	8A	8A	8A	10A
	L/R _{dc}	171nH/Ω	208nH/Ω	1340nH/Ω	5625nH/Ω
	Area	2.0mm ²	0.4mm ²	0.5mm ²	0.4mm ²
	Current Density	4A/mm ²	20A/mm ²	16A/mm ²	25A/mm ²
	Thickness	0.2mm	0.7mm	0.28mm	0.6mm

※1 出典: Intel Corporation, 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)

※2 動作温度範囲: -40℃~125℃

※3 I_{max}は磁気飽和条件に基づいて決定。

※本文中に記載のシリーズ名は、製品の種類や特性を示す品番の一部を抜粋したものであり、製品名または商標ではありません。

TAIYO YUDEN